

シンポジウム「重要性を増してきた電子回路、デバイスの放熱対策とその材料」

【開催日 2008 年 8 月 19 日(火)】

【主催】：化学工学会 エレクトロニクス部会

【協賛】：化学工学会 熱工学部会

車載用、民生家電、ハイパワーLED、LSIなどの電子回路、電子部品において、放熱対策が益々重要になってきた。今回はこの放熱対策、回路基板とその材料について、専門の方々に講演していただき、活発な議論を行う。

- ・日 時 2008 年 8 月 19 日(火) 11:20-17:25 懇親会 17:30-19:00
- ・会 場 東京工業大学、デジタル多目的ホール
案内：東急大井町線・目黒線の大岡山駅より徒歩 1 分(正門を入れて右手奥,約100m先の建物)
〒152-8552 目黒区大岡山2-12-1 東京工業大学 デジタル多目的ホール
- ・募集人員 200 名 申込先着順で、定員になり次第締め切ります。
- ・参加費：当日受付にてお支払い下さい。領収書を用意します。

大学関係者・学生	無料
化学工学会エレクトロニクス部会の個人会員および団体会員会社の社員	2 0 0 0 円
化学工学会 熱工学部会会員	2 0 0 0 円
上記以外の化学工学会会員、エレクトロニクス実装学会会員	5 0 0 0 円
その他 一般	8 0 0 0 円
- ・懇親会：2 0 0 0 円

プログラム

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ・深刻化する電子機器の熱問題とその対策 | 国峯尚樹氏 (株)サーマル デザイン ラボ |
| ・三次元実装における放熱対策 | 山地泰弘氏 産業技術総合研究所 |
| ・車載用基板電子製品に求められる放熱技術 | 松橋 肇氏 (株)デンソー |
| ・車載用放熱性配線板 | 長塩 修氏 日本シイエムケイ(株) |
| ・パワーLEDの特性と駆動方式および放熱設計 | 塚本勝孝氏 三ツ星産業(株) |
| ・高熱伝導性フレキシブル金属基板 | 米村直己氏 電気化学工業(株) |

オーガナイザー： 大阪府立大学 近藤和夫・齊藤丈靖、三井金属 石井正人、
住友ベークライト 老田尚久、京都大学 荻野文丸

* 申込先 大阪府立大学・近藤研究室・山本 E-Mail：electro@chemeng.osakafu-u.ac.jp
Tel：072-254-9304

下記の事項を、必ず、明記の上、申し込むこと。

- 1.氏名 (フリ仮名要)
- 2.勤務先住所 (所属部署まで)
- 3.メールアドレス
- 4.Tel/ Fax
- 5.懇親会参加の有無
- 6.会員資格 (化学工学会会員・化学工学会エレクトロニクス部会員と団体会員の社員・化学工学部熱工学部会員・エレクトロニクス実装学会会員・その他一般・大学関係者)